

★放熱性・信頼性UPに向けた各部材の開発動向と今後の課題とは！？

新刊書籍案内

★内部量子効率や光取り出し効率の改善方法を詳しく記載！

# 最新 LED 部材の開発

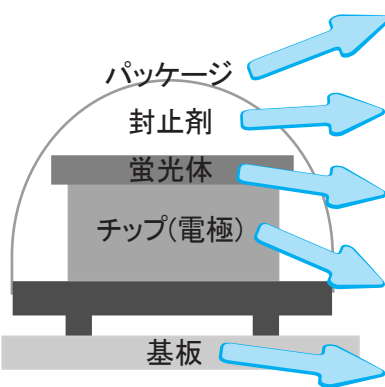
～チップ、蛍光体、基板、パッケージ、封止剤、市場・特許動向～

●発行：2007年4月27日 ●体裁：B5判 235頁 ●定価：79,800円(税込)

★ホームページで詳細内容をご覧ください。→ [http://www.gijutu.co.jp/doc/b\\_1389.htm](http://www.gijutu.co.jp/doc/b_1389.htm)

## 本書のポイント

- ・内部量子効率、光取り出し効率の向上策
- ・LEDの高出力化・熱対策のポイント
- ・紫外LEDの短波長化に向けた取り組み
- ・セラミックパッケージの放熱設計
- ・封止用エポキシ樹脂の劣化対策
- ・シリコン材料の耐熱性向上
- ・高熱伝導フレキシブル基板の開発状況
- ・新規蛍光体における発光特性の評価方法
- ・部材の市場展望と効果的な特許戦略



成形技術、反射率向上、高熱伝導化など

耐熱性、透明性、脆性改善など

材料合成、ナノ化、白色化など

高効率化、高出力化、演色性向上など

耐候性、耐紫外線性、放熱性改善など

## 執筆者（敬称略）

ローム(株)  
阿南工業高等専門学校  
三菱電線工業(株)  
名城大学  
ナイトライド・セミコンダクター(株)  
フィリップス・ルミレズ・ライティング  
カリフォルニア大学  
(株)住友金属エレクトロデバイス  
松下電工(株)  
松下電工(株)  
松下電工(株)  
松下電工(株)  
松下電工(株)  
(株)トクヤマ  
オムロン(株)

中原 健  
釜野 勝  
岡川 広明  
天野 浩  
川野 俊輔  
八木 隆明  
増井 久志  
日高 明弘  
池川 直人  
中原 陽一郎  
小林 充  
佐藤 正博  
井上 浩  
東 正信  
清本 浩伸

ジャパンエポキシレジン(株)  
信越化学(株)  
東亜合成(株)  
利昌工業(株)  
電気化学工業(株)  
タムラ化研(株)  
新潟大学  
京都大学  
(株)国際基盤材料研究所  
(株)国際基盤材料研究所  
(株)国際基盤材料研究所・  
(株)KRI  
(株)野村総合研究所  
谷・阿部特許事務所

大沼 吉信  
三好 敬  
佐々木 裕  
奥村 浩史  
米村 直己  
清田 達也  
戸田 健司  
田部 勢津久  
江原 摩美  
岸野 隆雄  
竹内 安正  
福井 俊巳  
前原 孝章  
新開 正史

### <申込要領>

- 本書籍は一般書店では取り扱いを致しておりません。
- ・右記申込書に必要事項をご記入の上、郵送又はFAXにてお送りください。
- ・ホームページからも申込みできます。 <http://www.gijutu.co.jp/> 申込書が到着次第、書籍・請求書をご送付いたします。
- 支払方法
- ・銀行振込または現金書留にてお願いいたします。
- ・郵便振替はございません。振込手数料はご負担ください。
- ・銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
- お申込・お問い合わせ先

〒141-0031 東京都品川区西五反田2-29-5 日幸五反田ビル8F



**技術情報協会**

TEL 03(5436)7744(代)

FAX 03(5436)5080

TECHNICAL INFORMATION INSTITUTE CO.,LTD.

(申込専用)

「LED部材」書籍申込書 (No1389) \*  
定価 79,800円(税込)

申込冊数.....冊

会社名			
所属			
(フリガナ) 氏名			E-mail
住所	〒		
TEL			FAX
今後ご希望しない案内方法に×印をしてください (現在案内が届いている方も再度ご指示ください) 【郵送(宅配便)・FAX・e-mail】			

ご記入いただいた個人情報は、商品の受付・商品発送・アフターサービスのために利用いたします。今後の案内ご希望の方には、その目的でも使用いたします。今後のご案内のため「個人情報の取り扱いに関する契約」を締結した外部委託先へ、個人情報を預託する場合があります。個人情報に関するお問合せ先: e-mail: privacy@gijutu.co.jp